

【太陽インキ製造】「JPCA Show 2025」出展のお知らせ

～車載用電子部品 品質基準規格 AEC-100Q Grade0 に対応する、 車載半導体パッケージ向け材料が第21回JPCA賞（アワード）受賞～

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤 英志、証券コード：4626）の子会社である太陽インキ製造株式会社（本社：埼玉県比企郡嵐山町、代表取締役社長：峰岸 昌司、以下「太陽インキ製造」）は、2025年6月4日（水）～6日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される、電子機器トータルソリューション展「JPCA Show 2025」第54回国際電子回路産業展に出展します。

ブース内では、「自動車向け製品」、「パワー半導体向け製品」、「高集積分野向け製品」、「ディスプレイ向け製品」、「その他」の5つのテーマを中心に世界の夢を叶える革新的な各種製品を展示します。今回、第21回JPCA賞（アワード）を受賞した、「車載半導体パッケージ向け高信頼性ドライフィルムタイプソルダーレジスト」をはじめ、PCB基板用高機能性ソルダーレジスト、パッケージ基板用高信頼性ソルダーレジスト、各種層間絶縁材料、各種穴埋め材料、ギャップ埋め材料、放熱材料、半導体封止材料、感光性カバーレイ、立体成型基板用材料、ディスプレイ向け各種材料等をご紹介いたします。また、立体成型基板用材料は、MIDパビリオンにも出展します。



【第21回JPCA賞（アワード）受賞製品について】

太陽インキ製造は今回で6年連続のJPCA賞（アワード）受賞です。

製品名：「車載半導体パッケージ向け高信頼性ドライフィルムタイプソルダーレジスト」

製品概要：車載半導体向けの高度な耐久性に対応するため、厚膜でも高い解像性を保つことで、クラックが発生しづらく、長期耐熱性、絶縁信頼性を有する、ドライフィルムタイプソルダーレジスト。

開発経緯：近年、自動車の電子化の進展に伴い需要が増加している車載半導体は、極端な温度変化など過酷な環境下にさらされることから、使用される材料や電子部品には高度な耐久性が求められます。こうした高い要求特性を満たすため、車載用電子部品にはAEC-Q100^{※1}という品質基準が設けられており、その中で最も厳しい条件であるGrade0に対応する、優れた耐久性を持つソルダーレジストとして、本製品を開発しました。



	Grade0	Grade1	Grade2	Grade3
使用温度	-40～150°C	-40～125°C	-40～105°C	-40～85°C
高温長時間保管	175°C 1000時間	175°C 500時間	150°C 500時間	
冷熱サイクル	-55～150°C 1500サイクル	-55～150°C 1000サイクル	-55～125°C 1000サイクル	-55～125°C 500サイクル
絶縁信頼性		bHAST 96時間/130°C/85%RH		

^{※1} Automotive Electronics Council - Q100 (AEC-Q100) 信頼性基準

<PRESS RELEASE>

■「JPCA Show 2025」出展概要

開催期間：2025年6月4日（水）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト 東6ホール（MIDパビリオン：東7ホール）

ブース番号：6G-01（MIDパビリオン：7G-17）

展示会詳細：<https://www.jpcashow.com/show2025/index.html>

当社出展内容：<https://jpca2025.tems-system.com/eguide/jp/jpca/details/fjhH2csaZGk>

【製品に関するお問い合わせ先】

太陽インキ製造株式会社 エレクトロニクス製品に関するお問い合わせ

info-taiyoink2010@taiyoink.co.jp